

테스(095610)

반도체 제조사 설비투자에 따른 매출 실적 증대 기대

기업정보(2021/09/30 기준)

대표자	주승일, 이재호
설립일자	2002년 09월 19일
상장일자	2008년 05월 20일
기업규모	중견기업
업종분류	반도체 제조용 기계 제조업
주요제품	PECVD 장비 등

시세정보(2021/12/20 기준)

현재가	27,200원
액면가	500원
시가총액	5,377억 원
발행주식수	19,768,226주
52주 최고가	37,700원
52주 최저가	24,250원
외국인지분율	8.81%
주요주주	
주승일 외 8인	29.31%
자사주	6.20%

■ 반도체 제조 전공정 중 증착공정용 장비 제조

테스(이하 '동사')는 반도체 제조 장비 개발 및 제조 기업으로, 전공정 중 증착공정에 사용되는 PECVD(Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition) 장비가 주요 제품이다. 해당 장비는 삼성전자와 SK하이닉스에 공급되며, 3D NAND 공정용 하드마스크 증착장비로 사용된다. 또한, 동사는 PECVD 기술을 적용한 OLED TFE용 대면적 증착장비, MOCVD 기술을 적용한 UVC LED용 증착장비를 개발하여 제조 중이고, 식각장비인 Gas Phase Etcher를 개발하여 공급하고 있다.

■ 전방산업의 설비투자 증가로 인한 매출 성장 기대

최근 SSD, USB 등 저장장치에 적용되는 플래시메모리는 대용량화가 요구되고 있다. 이에 따라 제조사들은 3D NAND의 고단화에 집중적으로 투자하고 있다. 고단화에 따른 증착공정 수 증가는 동사의 증착장비에 대한 수요와 직결된다. 삼성전자의 경우, 2022년 총 CAPEX(자본적 투자) 51.2억 원을 예상하며, 이 중 44조 원은 반도체 설비에 대한 CAPEX가 될 것으로 전망되고 있다. 이에 따라, 동사의 PECVD 장비에 대한 수요 증가도 기대된다.

■ 삼성전자와 119억 원 규모의 공급계약 체결

동사는 2021년 11월 3일 중국 소재의 삼성전자 반도체 공장에 119억 원 규모의 장비공급계약을 체결하였다. 또한, 삼성전자는 경기도 평택 소재의 P3 공장에 대한 설비투자를 연내 집행할 것으로 예상되며, 반도체 제조 전공정의 핵심 공정장비인 증착장비 수요 증가는 동사에 유리하게 작용할 것으로 보인다.

요약 투자지표 (K-IFRS 연결 기준)

구분 년	매출액 (억 원)	증감 (%)	영업이익 (억 원)	이익률 (%)	순이익 (억 원)	이익률 (%)	ROE (%)	ROA (%)	부채비율 (%)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	PBR (배)
2018	2,870.7	4.1	578.2	20.1	424.3	14.8	21.1	17.5	13.8	2,145	11,072	5.7	1.1
2019	1,783.7	-37.9	117.5	6.6	97.5	5.5	4.6	4.0	15.4	493	11,202	50.7	2.2
2020	2,459.7	37.9	316.8	12.9	300.2	12.2	13.3	11.5	16.2	1,519	12,521	19.5	2.4

기업경쟁력

반도체 증착장비 기술 확보

- 2018년 3D NAND 공정용 하드마스크 증착장비 개발로 대한민국 기술대상 대통령상을 수상
- 삼성전자와 SK하이닉스를 고객사로 확보
- 박막 특성 개선 장비 및 대형 장비의 연구개발 지속

보유 기술 기반으로 사업 다각화

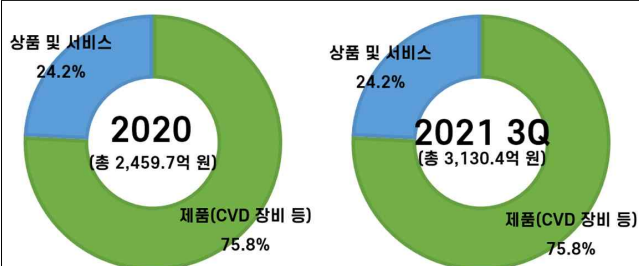
- 반도체 증착장비 기술을 바탕으로 OLED 공정용 장비 및 LED 공정용 장비를 개발하여 공급
- 반도체용 식각장비도 개발하여 DRAM 공정에 공급

핵심기술 및 적용제품

3D NAND 용 ACL PECVD 장비



최근 매출 구성비



시장경쟁력

반도체 제조사의 CAPEX 증가

- 2022년 국내 시장 300억 달러 규모 반도체 팹 장비 투자 예상
- 2022년 삼성전자 반도체 부문 44조 원 투자 전망

글로벌 광섬유 용착접속기 시장규모

년도	시장규모	성장률
2018년	5조 315억 원	7.1% ▲
2019년	3조 3,989억 원	32.4% ▼
2020년	3조 3,905억 원	0.2% ▼

3D NAND 고단화 이슈로 인한 설비투자 증가 예상

- 3D NAND 메모리 고단화를 통한 저장용량 증가의 요구가 증대
- 고단화에 따른 증착공정 증가는 증착장비 수요 증대로 연결

최근 변동사항

- NH투자증권과 100억 원 규모의 자사주 취득 신탁계약을 체결
- 삼성전자 중국 공장에 총액 119억 원 규모 계약 체결

ESG(Environmental, Social and Governance) 활동 현황

E

(환경경영)

- 당사는 ISO14001(환경경영시스템) 인증을 바탕으로 내부적인 자율관리 체제를 수립하여 따르고 있음.
- 당사는 환경 법규를 준수하여 모든 사업 활동을 수행하고 있으며, 생산 시 발생하는 환경오염물질을 제거하기 위한 방지시설을 설치하여 운영하고 있음.

S

(사회책임경영)

- 당사는 ISO45001(안전보건경영시스템) 인증을 취득한 바 있으며, 정기적인 안전교육을 시행하고 안전 관련 규정을 준수하여 근로자의 안전한 근무환경을 보장하고 있음.
- 당사는 산학 협력을 통한 반도체 인재 육성, 소외계층을 위한 기부 및 봉사활동을 꾸준히 이어가고 있음.

G

(기업지배구조)

- 당사는 윤리 규범을 공개하여 고객 만족과 주주가치 제고 등을 약속하고 있으며, 이해관계자가 비윤리 행위를 제보할 수 있는 온라인 신고 프로그램을 마련하여 부정을 방지하고 있음.
- 당사는 2013년부터 연속배당을 시행 중이며 최근 3년간 평균 배당수익률은 2.0%임.

NICE디앤비의 ESG 평가항목 중, 기업의 ESG 수준을 간접적으로 파악할 수 있는 항목에 대한 설문조사를 통해 활동 현황을 구성

I. 기업현황

3D NAND 고단화에 따른 증착장비 공급 증대 가시화

반도체 제조사의 메모리 반도체(3D NAND) 고단화에 따라 증착공정이 증가하여 동사의 증착장비 공급이 늘어나고 있다.

■ 기업 개요

동사는 2002년 9월 설립되어, 반도체 전공정 장비를 주력으로 제조하고 있으며, 2008년 5월 코스닥에 상장되었다. 주요주주는 각자대표이사 주승일 외 8인으로, 동사의 지분 30.67%를 보유하고 있으며, 중국 시안 소재의 삼성전자 공장과 우시 소재의 SK하이닉스 공장에 납품한 장비의 사후관리를 위해 시안과 우시에 각각 법인을 설립하여 운영 중이다.

[표 1] 동사의 연결 종속회사 현황

상호	설립일	주요 사업	지분율	소재지
시안테스반도체설비	2013.08.15	반도체 장비 유지보수 서비스	100%	중국 시안
우시테스반도체설비	2018.03.23	반도체 장비 유지보수 서비스	100%	중국 우시

*출처: 동사 3분기보고서(2021.09.30), NICE디앤비 재구성

■ 반도체 제조 전공정 중 증착공정용 PECVD 장비 제조

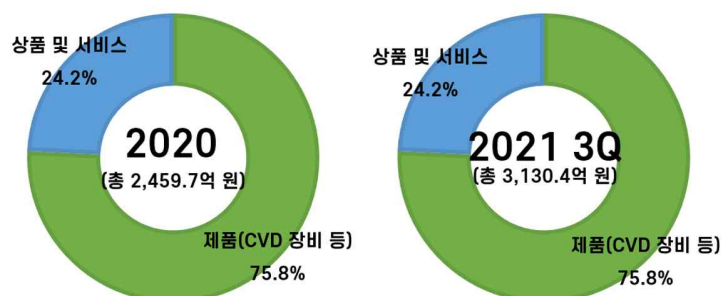
동사의 주요 제품은 메모리 반도체인 3D NAND 제조 공정 중 전공정, 그 중 증착공정에 사용되는 PECVD 장비이다. 동 장비는 ACL(Amorphous Carbon Layer, 비정질탄소막)을 웨이퍼에 증착하는 장비이다. ACL은 공정 미세화에 의해 필요성이 대두된 하드마스크로, 회로 패턴을 형성하는 식각공정에서 희생막 역할을 한다. ACL은 기존 실리콘 주성분의 하드마스크와 달리 탄소가 주성분으로, 수소와 같은 비할로젠 계열의 가스로도 충분히 식각이 가능하다.

[그림 1] 동사의 PECVD 장비



출처: 동사 홈페이지

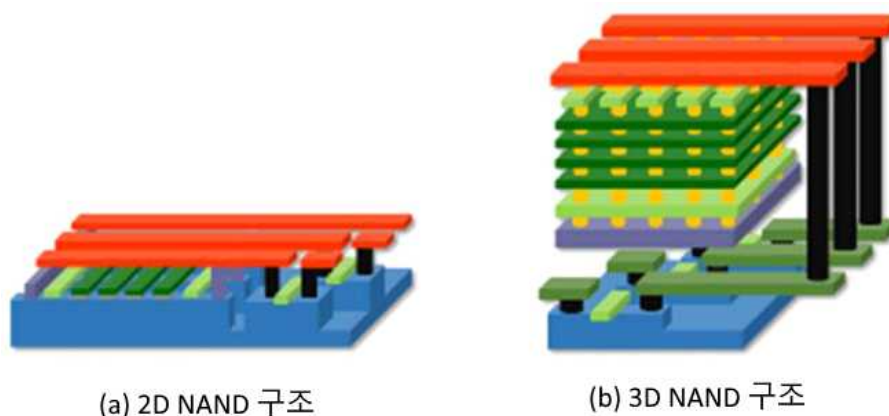
[그림 2] 동사의 매출비중



출처: 동사 3분기보고서(2021.09.30), NICE디앤비 재가공

3D NAND는 SSD, USB 등의 저장장치에 사용되는 비휘발성 메모리이다. 최근 기존의 2차원 평면 상에 많은 메모리 셀을 넣는 방식을 탈피하고 3차원 수직 구조로 다층을 형성하여 메모리 셀의 집적도를 높이는 방식으로 저장용량을 늘리고 있다. 컴퓨터, 스마트폰 등 고용량의 저장장치가 필요한 디바이스의 수요가 증가함에 따라 3D NAND 메모리의 고단화가 이루어지고 있다. 3D NAND 공정은 각층을 형성할 때마다 미세 패턴 형성 공정이 필요하고, 92단, 128단, 160단처럼 적층 단수가 높아질수록 미세 패턴 형성을 위한 증착공정의 수가 증가하므로 증착장비의 수요 또한 증가하게 된다.

[그림 3] NAND 메모리의 구조 비교



*출처: Micron, NICE디앤비 재구성

■ 공정활용도가 높은 PECVD 방식

CVD(화학기상증착, Chemical Vapor Deposition)은 박막 증착의 한 방법으로, 기체 형태로 반응물이 웨이퍼에 공급되면 표면의 높은 온도 등으로 인해 화학반응이 표면이 일어나 박막이 증착되고, 부산물은 다시 기체 형태로 빠져나가는 방식이다. CVD는 반응에 필요한 에너지 공급 방식과 공정 압력에 따라 LPCVD, PECVD 등으로 분류되며, 해당 공정에 가장 알맞은 방법이 사용된다. 동사가 사용하는 PECVD 방식은 Plasma Enhanced CVD의 약자로 플라즈마를 이용하여 반응에 필요한 에너지를 공급하여 증착 속도를 높이는 방식이다. PECVD 방식은 저온에서 공정이 가능하고 증착 속도가 높아 생산성이 좋은 특징이 있어 희생막으로 사용되는 ACL 증착에 적합한 방식이다.

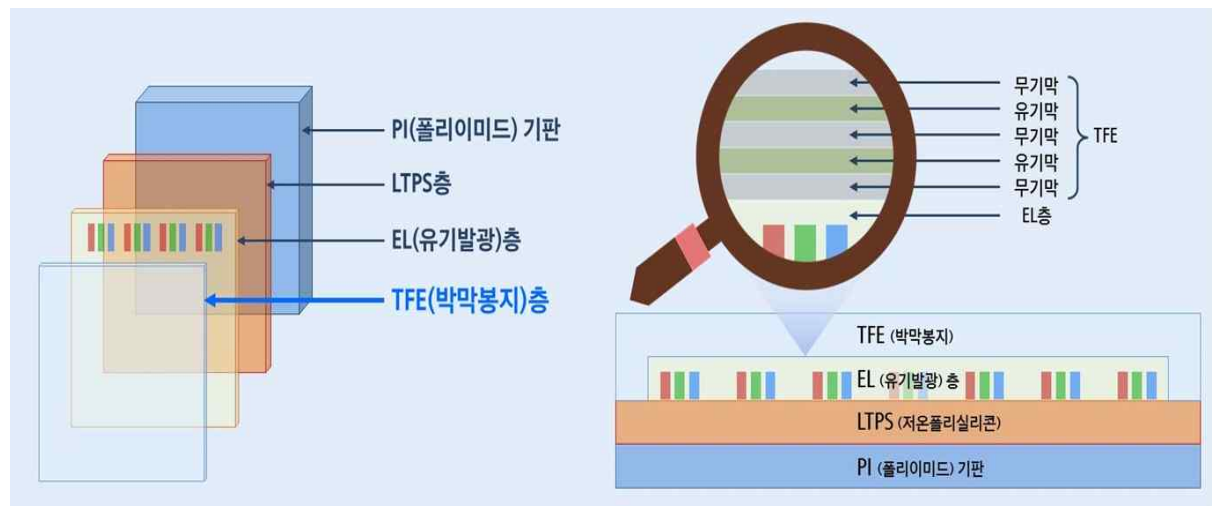
[표 2] 증착 방식별 성능 비교

	LPCVD	MOCVD	PECVD	ALD
특징	Inorganic source	Metalorganic source	낮은 공정온도	단원자층 제어
공정온도	~600°C	~400°C	-	<400°C
공정압력	0.1~10torr	10~760torr	0.01~10torr	0.01~760torr
증착반응형태	표면 및 기상반응	표면 및 기상반응	표면 및 기상반응	표면반응
단차 도포성	매우 우수	우수	우수	매우 우수
입자오염	보통	보통	보통	우수
두께조절 인자	가스공급량, 온도 시간 등	가스공급량, 온도 시간 등	가스공급량, 온도 시간 등	공정 사이클 수
조성 조절	어려움	어려움	-	쉬움

*출처: KISA, NICE디앤비 재구성

PECVD는 공정 활용도가 높아 ACL 외 다른 박막의 증착에도 활용이 가능하며, 동사의 장비는 SiON, SiN, SiO₂, SiCN의 박막도 증착이 가능하다. 동사는 이러한 PECVD 기술을 바탕으로 OLED TFE(박막봉지, Thin Film Encapsulation)용 대면적 PECVD 장비도 개발하여 공급하고 있다. OLED는 유기물과 전극보호를 위하여 깨지기 쉬운 유리 대신 깨지기 쉬운 유리 대신에 공기와 수분 침투를 방지할 수 있는 TFE를 보호층으로 사용한다. TFE는 무기막과 유기막의 다층으로 구성되며, PECVD는 무기막을 형성하는 역할을 한다.

[그림 4] OLED TFE 구조



*출처: 삼성디스플레이

■ 지속적인 연구개발을 통한 다양한 장비 개발

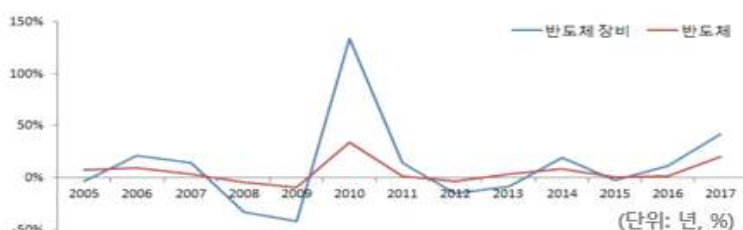
동사는 PECVD 장비에 대한 개발을 지속적으로 수행하고 있으며, 시스템 최적화와 공정반응물인 차세대 전구체(Precursor) 적용 등을 통해 박막 밀도를 높여 내식각성이 향상된 ACL 장비를 개발하였다. 동사는 ACL 박막의 식각 선택비, 단차도포성, 밀도, 증착 속도 등의 특성을 지속적으로 평가하여 반도체 공정의 미세화와 3D NAND 공정의 고단화에 대비하고 있으며, 450mm 웨이퍼에 대응이 가능한 PECVD 장비 또한 개발하였다.

또한, 다른 방식의 증착 기술인 MOCVD 기술을 적용한 UVC LED용 웨이퍼 제작에 사용되는 증착장비를 개발하여 납품하고 있으며, 식각장비(Gas Phase Etcher)를 개발하였다. 동사의 식각장비는 기존 DRAM 공정을 넘어 NAND 공정에도 적용가능하여 2019년 이후부터 확대 공급되었다.

■ 반도체 제조사의 CAPEX에 따른 장비 시장의 성장 기대

반도체 장비 산업은 후방산업과의 연계성이 큰 산업으로 반도체 제조업체의 설비 투자 계획에 직접적인 영향을 받으며, 반도체 산업 또는 타 산업 대비 경기 변동의 폭이 크다. 반도체 산업이 호황일 경우 설비 투자로 인하여 반도체 장비 산업은 큰 폭으로 성장하나, 불황일 경우에는 큰 폭의 위축을 보인다.

[그림 5] 반도체 산업과 장비 산업의 성장률 비교



*출처: SEMI, IC Insights, WSTS, 한국수출입은행

국제반도체장비재료협회(SEMI)의 최신 보고서에 따르면 2021년 세계 반도체 전공정 설비 투자액은 약 900억 달러에 이를 것으로 내다보았으며, 2022년에는 1,000억 달러에 육박하며 사상 최대 기록을 경신할 것으로 예상했다. 이 중 메모리 분야에 대한 투자는 약 380억 달러, DRAM 및 NAND 분야는 각각 170억 달러와 210억 달러가 될 것으로 보인다. 한국은 2022년 300억 달러(약 35조 원) 규모의 반도체 장비 투자가 이루어질 것으로 예상했다.

국내 증착장비 시장의 경향도 반도체 장비 산업의 전반적인 경향을 따를 것으로 전망되고 있다. 시장조사기관인 Gartner에 따르면, 국내 증착장비 시장규모는 2017년 급성장하여 2018년 5조 315억 원 규모에 도달하고, 이후 급격히 감소하여 2020년 3조 3,905억 원 규모까지 감소한 뒤 완만한 회복세를 보일 것으로 전망되었다.

[그림 6] 글로벌 반도체 전공정 설비 투자액 추이(좌) 및 국내 증착장비 시장규모(우)



글로벌 반도체 장비 투자 예상

국내 증착장비 시장규모

*출처: SEMI, Gartner, NICE디앤비 재구성

삼성전자의 경우, 2022년 총 CAPEX 51.2억 원을 예상하고 있다. 이 중 44조 원은 반도체 설비에 대한 CAPEX가 될 것으로 전망되고 있다. 앞서 언급한 3D NAND 고단화 이슈와 맞물려 동사의 PECVD 장비에 대한 수요 증가는 당연한 수순으로 보인다.

한편, 세계시장에서 반도체 전공정 장비 시장 점유율을 살펴보면, Applied Materials 16.4%, ASML 15.4%, Tokyo Electron 12.3%, Lam Research 10.8%, KLA 6.2%, 기타 38.8%로 집계되었다.(출처: The Information Network, 2020년 자료)

국내 증착장비 제조사로는 원익IPS, 주성엔지니어링 등이 있다.

(원익IPS) 원익IPS는 코스닥 상장사이며, 반도체 및 디스플레이 장비 제조 기업이다. 비메모리 증착 장비 대량 생산 업체로 비메모리 증착 장비 국산화에 성공하였으며, PECVD를 주력으로, 최근 ALD로 확장하고 있다. 2020년 매출액 1조 909억 원, 영업이익 1,406억 원을 기록하였다.

(주성엔지니어링) 주성엔지니어링은 코스닥 상장사이며, 반도체, 디스플레이, 태양전지 제조 장비를 주 사업으로 영위하고 있다. 반도체의 막 증착 장치 분야 중 선택적 반구형 실리콘 증착 분야 및 원자층 증착 분야 등에서 독자적인 기술을 확보하고 있다. 2020년 매출액 1,185억원, 영업적자 250억 원을 기록하였다.

[그림 7] 주요 경쟁사 비교

(단위: 억 원)

		2018	2019	2020
동사	매출액	2,871	1,784	2,460
	영업이익	578	117	317
	순이익	424	98	300
원익IPS	매출액	6,493	6,692	10,909
	영업이익	1,059	411	1,406
	순이익	869	429	978
주성엔지니어링	매출액	2,630	2,546	1,185
	영업이익	412	291	-250
	순이익	427	271	-82

*출처: 각 사 사업보고서(2020), NICE디앤비 재구성

■ 장비 개발 역량 보유하였으나, 편중된 매출구조 개선 필요

[그림 8] SWOT 분석

Strength

- 시장 진입장벽이 높은 반도체 전공정장비 분야에서 증착장비 인지도 확보
- 증착장치 기술 내재화로 신규 장비 개발 역량 확보

- 3D NAND 기술의 고층화로 ACL 장비 수요 증가
- 삼성전자의 신규 설비 투자 계획

Opportunity

Weakness

- 삼성전자와 SK하이닉스의 국내 반도체 제조 업체에 편중된 매출구조
- 반도체 공정용 PECVD 증착 장비에 편중된 매출구조

- 후방산업인 반도체 산업의 경기변동에 의존적인 산업 구조
- SK하이닉스의 보수적인 설비 투자 계획

Threat

■ 동사의 ESG 활동



동사는 환경(E) 부문에서 ISO14001(환경경영시스템) 인증을 바탕으로 모든 사업 활동에서 환경 법규를 준수하고 내부적인 자율관리 체제를 강화하고 있다. 동사와 밀접한 연관이 있는 환경 이슈에 대해 환경안전방침을 수립해 이행하고 있으며, 자원의 효율적인 사용과 폐제품의 재활용 등을 통해 환경 개선 활동에 적극적으로 참여하고 있다. 모든 임직원은 에너지 효율이 높은 제품을 우선 채택하여 에너지 절약에 앞장서고 있으며, 일회용품 사용을 줄이고 있다. 또한, 동사는 제품의 개발, 생산, 판매, 유통, 폐기 등을 수행하는 과정에서 발생하는 폐기물, 유해물질을 최소화하고 있으며, 환경오염물질을 제거하기 위한 방지시설을 설치하여 운영하고 있다.



동사는 사회(S) 부문에서 근로자의 안전을 우선으로 삼아 ISO45001(안전보건경영시스템) 인증을 취득하고 관련된 안전보건 규정을 준수하고 있으며, 정기적인 안전교육을 시행하고 있다. 또한, 자연재해로 발생할 수 있는 비상사태 및 사고에 대해서 사전에 평가하여, 대응 가능한 절차를 마련하고 훈련을 통해 근로자의 안전한 근무환경을 제공하기 위해 노력하고 있다.

동사는 임직원의 자원봉사, 재난구호 등의 봉사활동 참여를 장려하고 있으며, 소외계층을 위한 기부활동과 인재양성 활동을 꾸준히 이어가고 있다. 동사는 장애인 및 요양보호시설과 위탁 아동 보호시설 등에 2004년부터 기부금을 전달하고 UNICEF에도 정기적인 기부활동을 하고 있다. 동사는 자원 봉사단을 구성하여 지역 복지시설 봉사활동에 참여하고 매년 2회 정기적인 헌혈 및 헌혈증서 기부를 진행하고 있다. 또한, 충북 반도체 고등학교와 협약을 체결하여 실무교육, 대학생 장학금 지원 등을 통해 반도체 엔지니어 양성을 위해 힘쓰고 있다.

동사의 분기보고서(2021.09)에 의하면 동사는 모든 근로자를 정규직으로 채용 중이며 동사의 여성 근로자의 비율은 4.4%로 동 산업(C29, 기타 기계 및 장비 제조업)의 여성 근로자 비율인 13.9% 이하로 남성 중심의 고용이 이루어지는 것으로 확인된다.

[표 3] 동사 근로자 성별에 따른 근속연수 및 급여액

(단위: 명, 년, 천 원)

성별	직원 수		평균근속연수		1인당 연평균 급여액	
	동사	동 산업	동사	동 산업	동사	동 산업
남	368	328,595	6.3	6.9	66,326	47,844
여	17	53,265	4.5	6.0	38,118	35,136
합계	385	381,860	-	-	-	-

*출처: 고용노동부 「고용형태별근로실태조사」 보고서 (2021.02), 동사 3분기보고서(2021.09.30), NICE디앤비 재구성



동사는 지배구조(G) 부문에서 고객 만족과 주주가치 제고, 건전한 조직문화 형성 등을 약속하는 윤리 규범을 공개하고 있으며, 동사의 임직원은 제정된 윤리 행동 규범 가이드 라인을 따라 윤리경영을 실천하고 있다. 또한, 동사는 임직원, 협력회사, 고객 등의 이해관계자가 불공정한 업무처리나 금품 향응의 제공, 비리 행위 등을 신고할 수 있는 온라인 신고 프로그램을 운영하고 있으며, 신고자 보호를 위해 제보는 비공개로 처리된다.

동사 3분기보고서(2021.09)에 의하면 동사의 이사회는 사내이사 3인 사외이사 1인으로 구성되어 있으며 상근감사를 선임하고 감사 지원조직을 구성하여 내부회계관리제도의 평가 및 운영에 관한 업무를 수행하고 있다. 동사는 주주이익 환원을 위해 2013년부터 총 8회의 연속 결산 배당을 시행하였고 최근 3년간 평균 배당수익률은 2.0%이다.

[표 4] 동사의 지배구조

(단위: 명, %)

이사회		감사		주주	
의장, 대표이사의 분리	-	회계 전문성	-	최대주주 지분율	29.26
사내/사외	3/1	특수관계인	-	소액주주 지분율	59.66
사외이사 재직기간	6년 미만	내부통제 제도	○	3년 이내 배당	○
내부위원회	-	감사 지원조직	○	의결권 지원제도	○

출처: 동사 3분기보고서(2021.09.30), NICE디앤비 재구성

II. 재무분석

주요 고객사의 반도체 전공정 장비 투자 재개 등에 따른 수혜로 매출 성장 전망

2020년 삼성전자, SK하이닉스 등 주요 고객사의 신규 투자 재개 및 적기 대응 등에 힘입어 전반적인 영업실적이 개선된 모습을 보였으며, 2021년 주요 고객사들의 NAND 투자 가속화 등에 따른 수혜가 동사에 집중 되고 있는 점 등을 고려 시 매출 성장이 전망된다.

■ 반도체 장비가 동사의 매출을 견인

동사는 반도체 전공정 장비의 제조 및 판매를 주력 사업으로 영위하고 있으며, PECVD와 Gas Phase Etcher 장비를 주요 제품으로 생산하고 있다. 그 외 디스플레이와 UVC LED용 장비 사업도 병행하고 있으나 총매출 대비 관련 매출 비중은 낮은 수준이다. 2020년 기준 부문별 매출 비중은 반도체 장비 사업 97.1%, 반도체 장비 외 사업(디스플레이 장비 등) 2.9%를 각각 차지하고 있어 반도체 장비가 동사의 매출을 견인하고 있는 것으로 분석된다.

한편, 동사는 국내를 비롯하여 해외 판매를 병행하고 있으며, 최근 3개년간 해외 판매를 통한 매출 비중은 2018년 13.5%, 2019년 35.3%, 2020년 43.8%를 각각 기록하며 수출 의존도가 가중되는 모습을 보였다.

■ 주요 고객사의 신규투자 재개로 '20년 외형 회복, '21년 3Q 누적 매출 추이 양호

2019년 전방산업인 반도체 산업의 업황 둔화 및 주요 고객사들의 설비투자 축소 등의 영향으로 1,783.7억 원(-37.9% YoY)의 매출액을 기록하며 외형 규모가 위축된 모습을 보였으나, 2020년 주요 고객사인 삼성전자, SK하이닉스의 NAND 및 DRAM 투자에 힘입어 전년 대비 37.9% 증가한 2,459.7억 원의 매출액을 실현하며 일부 외형이 회복된 모습을 보였다.

2021년 삼성전자의 평택 2공장 NAND 및 DRAM 투자, SK하이닉스의 128단 업그레이드 투자 등에 따른 관련 장비의 공급물량 증가로 2021년 3분기 누적 매출액은 전년 동기 대비 63.5% 증가한 3,130.5억 원을 기록하며 큰 폭의 외형 성장을 나타냈다.

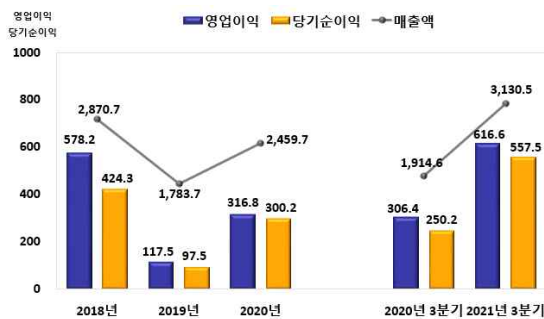
■ '21년 3Q 전년에 이어 매출 급증에 힘입어 수익성 개선 추세 지속

2020년 매출 회복에 따른 영업비용 부담 완화에 힘입어 매출액영업이익률 및 매출액순이익률은 각각 12.9%(+6.3%p YoY), 12.2%(+6.7%p YoY)를 기록하며 전반적인 수익성이 전년 대비 개선된 모습을 보였다. 상기 매출 규모의 확대 및 수익성 개선으로 2020년 동사는 영업이익 316.8억 원(+169.6% YoY), 당기순이익 300.2억 원(+207.9% YoY)를 기록하였다.

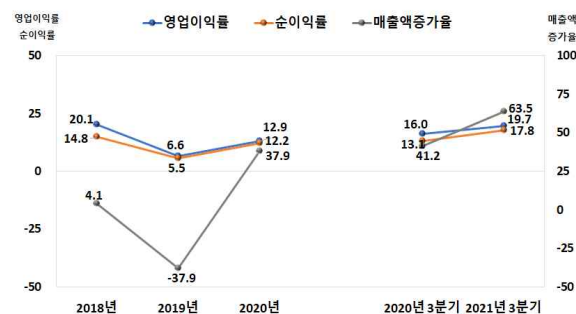
2021년 3분기 누적 매출액 기준 매출액영업이익률은 19.7%(+3.7%p YoY)으로 영업이익은 전년 동기 대비 101.2% 증가한 616.6억 원을 기록하였다. 이는 매출 신장 등에 따른 판관비 부담 완화 및 원가구조 개선에 기인한 것으로 파악된다. 아울러 금융자산평가 등 금융수지 개선으로 매출액순이익률 역시 17.8%(+4.7%p YoY)를 기록하며 전년 동기 대비 상승하였다.

[그림 9] 동사 연간 및 3분기(누적) 요약 포괄손익계산서 분석

(단위: 억 원, %, K-IFRS 연결기준)



매출액/영업이익/당기순이익 추이



증가율/이익률 추이

*출처 : 동사 사업보고서(2020), 3분기보고서(2021.09.30), NICE디앤비 재구성

■ 꾸준한 흑자시현 등으로 전반적인 재무안정성 지표 양호한 수준 유지

양호한 수익구조를 바탕으로 한 지속적인 순이익 내부유보로 최근 3개년간 이익잉여금을 포함한 자기자본 규모가 확대 추이를 보이고 있으며, 2020년 말 기준 주요 재무안정성 지표는 부채비율 16.2%, 자기자본비율 86.0%를 기록하며 전년 말에 이어 양호한 수준을 유지하였다. 한편, 투자활동 및 재무활동에 필요한 자금을 영업활동창출자금과 보유 현금 일부를 재원으로 충당하고 있어 2020년 말 현금성자산 규모는 전년 말 586.5억 원에서 390.4억 원으로 축소되었으나, 유동비율이 490.9%로 양호하고 차입금 규모 역시 총자산의 5.0% 미만으로 미미한 수준인 바, 단기유동성 위험은 낮은 것으로 분석된다.

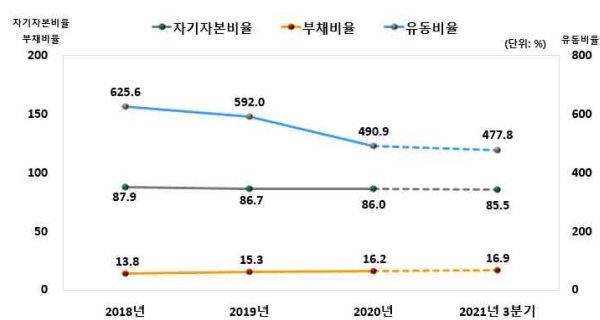
이후 2021년 9월 말 기준 주요 재무안정성 지표는 부채비율 16.9%, 자기자본비율 85.5%를 기록하는 등 전년 동기 대비 소폭 개선된 모습을 보이며 양호한 재무구조를 유지하였다.

[그림 10] 동사 연간 및 3분기(누적) 요약 재무상태표 분석

(단위: 억 원, %, K-IFRS 연결기준)



자산/부채/자본 비교



자본구조의 안정성

*출처 : 동사 사업보고서(2020), 3분기보고서(2021.09.30) NICE디앤비 재구성

[표 5] 동사 연간 및 3분기(누적) 요약 재무제표

(단위: 억 원, K-IFRS 연결기준)

항목	2018년	2019년	2020년	2020년 3분기	2021년 3분기
매출액	2,870.7	1,783.7	2,459.7	1,914.6	3,130.5
매출액증가율(%)	4.1	-37.9	37.9	41.2	63.5
영업이익	578.2	117.5	316.8	306.4	616.6
영업이익률(%)	20.1	6.6	12.9	16.0	19.7
순이익	424.3	97.5	300.2	250.2	557.5
순이익률(%)	14.8	5.5	12.2	13.1	17.8
부채총계	293.9	329.8	383.7	432.0	474.9
자본총계	2,124.4	2,149.2	2,365.0	2,280.4	2,805.0
총자산	2,418.2	2,479.0	2,748.7	2,712.4	3,279.9
유동비율(%)	625.6	592.0	490.9	467.8	477.8
부채비율(%)	13.8	15.3	16.2	18.9	16.9
자기자본비율(%)	87.9	86.7	86.0	84.1	85.5
영업현금흐름	360.0	332.6	247.7	265.9	687.1
투자현금흐름	66.5	-43.3	-278.4	-384.6	-199.5
재무현금흐름	-227.9	25.9	-157.6	-106.2	-118.9
기말 현금	272.4	586.5	390.4	360.1	765.7

※ 분기: 누적 실적

*출처: 동사 사업보고서(2020), 3분기보고서(2021.09.30)

Ⅲ. 주요 변동사항 및 향후전망

반도체 산업의 설비 투자 회복에 힘입어 중장기적인 성장 기대

반도체 장비 산업은 후방산업과의 연계성이 큰 산업으로 반도체 제조업체의 설비 투자 계획에 직접적인 영향을 받는다. 현재 주 고객사인 삼성전자, SK하이닉스 등의 투자가 지속되고 있어 중장기적인 성장이 기대된다.

■ 2021년 반도체 산업의 업황 회복 속 매출 성장 전망

2021년 주요 고객사들의 NAND 및 DRAM 투자 등이 지속되며 전방산업의 업황이 회복되었고 이로 인해 2021년 3분기 누적 매출액은 전년 동기 대비 63.5% 증가하였다. 더불어 매출 성장에 따른 판관비 부담 완화 및 원가구조 개선 등으로 매출액영업이익률 및 매출액순이익률은 각각 19.7%(+3.7%p YoY), 17.8%(+4.7%p YoY) 상승하는 등 전반적인 수익성이 전년 동기 대비 개선되며 양호한 수준을 유지하였다.

한편, 동사의 주력 제품인 PECVD 장비는 앞서 언급한 바와 같이 3D NAND 투자 시 꼭 필요한 장비로 3D NAND 투자 사이클에 연동되는 구조를 보이고 있으며, 과거 2017~2018년 3D NAND 투자가 집중되었던 시기에 사상 최고의 매출을 올린 바 있다. 2021년에도 주 고객사인 삼성전자와 SK하이닉스가 3D NAND 투자 규모를 확대할 것으로 전망되고 있어 향후 중장기적으로 매출 성장세가 지속될 것으로 분석된다.

■ 2021년 하반기 주요 이슈

동사의 2021년 하반기 주요 이슈를 살펴보면, 2021년 8월, 동사는 NH투자증권과 100억 원 규모의 자사주 취득 신탁계약을 체결했으며, 이를 통하여 주가 안정 및 주주가치 제고를 꾀하고 있다. 계약기간은 2022년 2월 4일까지다.

또한, 동사는 2021년 11월 삼성전자의 중국 공장에 119억 원 규모의 장비 공급계약을 체결하였다. 이는 지난해 연결기준 매출액 대비 4.84%에 해당하는 금액이며, 계약기간은 2021년 11월 2일부터 2022년 1월 29일까지다. 삼성전자의 반도체 관련 CAPEX의 신호탄으로 판단된다.

■ 증권사 투자의견

작성기관	투자의견	목표주가	작성일
유안타증권	Buy	49,000원	2021.04.22
	■ 삼성전자와 SK하이닉스의 Capex 스케줄이 앞당겨지면서 동사의 실적 모멘텀이 상반기에 집중될 전망		
	■ 삼성전자와 SK하이닉스의 3D NAND Migration이 가속화되면서 단위당 장비 투자가 빠른 속도로 늘어나고 있다는 점이 동사 실적에 긍정적으로 작용		
	■ 2Q21 보수적인 가정에도 동사의 매출액과 영업이익은 각각 901억 원(YoY 17%, QoQ -24%), 207억 원(YoY 51%, QoQ -27%, OPM 23%)에 달할 전망		

키움증권	Buy	38,000원	2021.09.15
	■ 3Q21 실적은 매출액 560억 원(-46% QoQ)와 영업이익 57억 원(-74% QoQ) 전망 ■ 다만, 이를 저점으로 실적 턴어라운드를 기록할 것으로 예상되는데, 3Q21 후반부터 SK하이닉스와 삼성전자의 반도체 전공정 장비 투자가 재개될 것으로 예상하기 때문 ■ 동사의 분기 영업이익은 각각 4Q21 65억 원, 1Q22 205억 원, 2Q22 243억 원, 3Q22 405억 원을 기록하며 큰 폭의 성장률을 기록할 것으로 예상		
한화 투자증권	Buy	36,000원	2021.11.15
	■ 3Q21 실적은 매출액 550억 원, 영업이익 63억 원으로 당사 추정치를 각각 2.3%, 3.2% 상회 ■ 4Q21 매출액은 600억 원을 소폭 상회할 것으로 전망되며 계절적으로 성과급, 일회성 비용 등이 반영될 것으로 예상되어 영업이익률은 5~6% 기록 예상 ■ 4Q21 삼성전자 평택 2공장 잔여 공간 투자가 지속되고, SK하이닉스 M16 디램 투자와 낸드 업그레이드 투자가 반영될 것		

■ 시장정보(주가 및 거래량)

동사 1개년 주가 변동 현황



*출처 : 네이버금융(2021년 12월 8일)